

公告编号： 2017-008

证券代码： 833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司

关于投资新建厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 投资项目概述

（一）项目概况

为适应公司业务发展，进一步提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在现有厂区内投资新建LED驱动集成电路封装与测试项目生产线二期建设项目厂房，项目产品确定用无卤塑封料的集成电路，封装形式为T0-94-2D，形成日产能2000万只，年封装能力24000万只，使南通华隆微电子股份有限公司在该领域独占鳌头。其中土地面积6588平方米，厂房面积10713平方米，项目备案总投资为4500万元，厂房预算总投资额约为人民币2000万元。

（二）审议和表决情况

公司于2017年3月28日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于新建LED驱动集成电路封装与测试项目生产线二期建设项目厂房的议案》。

本次投资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 投资项目基本情况

（一）项目名称：LED驱动集成电路封装与测试项目生产线二期

建设项目车间三、车间四工程。

(二) 项目地点：兴东镇孙李桥村西八组公司现有厂区内。

(三) 项目投资预算：预算总投资额约为人民币 2000万元。

(四) 项目内容：新建厂房面积 10713 平方米。

(五) 项目实施计划：根据工程项目的的设计情况，建设期为240 天，计划开工日期2017年5月(具体视各项前期准备工作进展情况确定)，计划竣工日期2017年12月。

(六) 项目资金来源：项目贷款500万元，其余公司自筹。

三、 项目实施对公司的影响

本项目属新厂区建设，期间现有厂区将正常生产经营，对公司业绩不会产生重大影响。扩建完成后，公司生产产能将大幅提高，有效缓解目前的生产压力，解决公司未来发展面临的产能瓶颈制约问题，同时也为未来新项目的引进、新产品的开发提供了空间。

四、 备查文件目录

《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2017年3月30日